

武漢熱線

大分市武漢事務所
趙 南 星

Wu-han Hot Line

武漢東湖ハイテク開発区(中国光バレー)について

武漢には国家レベルの開発区が3つあり、そのうち、武漢東湖ハイテク開発区は、ハイテク産業、光通信・光ファイバー産業の集中する基地であり、中国の光バレーとも呼ばれている。

2014年1月、中国同済大学研究院が発表した「2013年度中国産業園区持続的発展ブルーブック」及び「中国産業パークトップ100リスト」では、武漢東湖ハイテク開発区は第6位に挙げられている。中国中西部にある産業パークからトップ10以内に選ばれているのは、武漢東湖ハイテク開発区のみであった。また、2013年度の企業収入総額が6517億元(約11兆789億円)に達し、前年度比30.18%の成長となり、全国のハイテク開発区の中では、総合実力3位、知的創造力及び技術革新力2位となった。

概要

武漢東湖ハイテク開発区は武漢市の南東部に位置し、東湖風景区(国立公園)に隣接している。パーク内には東湖、南湖、湯遜湖等の多くの湖や珞珈山等の山があり、景色がすばらしく、環境に恵まれており、優秀な人材が集まるところとして有名である。

同開発区は1988年10月に建設され、1991年3月、國務院により初めて国家レベルのハイテク産業開発区として承認され、2001年、光電子産業基地(武漢・中国光バレー)として承認された。また、2009年12月には、国家自主イノベーションモデル区として國務院に承認された。敷地総面積は518平方キロメートル、人口40万人。光電子情報産業をメインとして、バイオ、省エネ・環境保護、高性能設備製造、ハイテクサービス、人材育成インキュベーターが互いに競争し発展するシステムを構築した。また、大学の科学技術パーク、光バレーソフパーク、フォックスコン武漢科学技術パーク、武漢国家バイオ産業基地、佛祖嶺地区産業パーク、花山生態新城、武漢未来科技城、総合保税區、左嶺新城及び自動車電子、金融センター、武漢鉄鋼、武漢重工、武漢ボイラー等の10ヶ所の産業パークも相次いで建設された。

光バレーと言われるように、光ファイバーケーブルの生産規模は世界一で、国内市場のシェアは66%以上を占め、国際市場のシェアでも25%を占める。ファイバーケーブル以外にも、光電子デバイス、レーザー製品の国内市場シェアも60%を超え、国際市場にも参入している。

現在、開発区に登録している企業は18,000社を超え、そのうち、世界TOP500に挙げられる企業が50社以上、上場企業が30社以上である。

優秀な人材及び外資導入

2000年、「武漢・中国光バレー」は東湖ハイテクゾーンにおいて「武漢・中国光バレー」の建設を中心とし、科学技術ニュータウンの建設・大産業の集中を手始めに、産業を発展させるとともに、環境保全に取り組み、企業誘致・外資導入にいっそう力を入れた。同開発区には武漢大学、華中科学技術大学など18校の大学と高等専門学校および55の科学研究機構が集中し、1000社以上のハイテク企業がハイテクの研究、開発、生産に従事しており、アメリカ、イギリス、フランス、日本、ドイツ、シンガポール、香港、台湾など23の国と地域から外資

が導入され、世界企業ベスト500に名を連ねているドイツのシーメンス、クルップ、アメリカのモトローラ、ウエストハウス・エレクトリックス、スウェーデンのエクリソン、オランダのフィリップスなどの多国籍企業が同開発区でハイテク産業を興している。

特に、武漢市内に300社ある日系企業のうち、烽火藤倉光ファイバー科学技術有限公司、NEC、中日合資武漢愛機自動車部品有限公司をはじめとする45社が開発区内にあり、武漢市の中で最も日系企業が集中している。

政府の政策

2001年9月、市政府は武漢光電子情報産業基地建設を支持するいくつかの政策に関する通達を出した。土地収用、商工業管理登録、金融、人材育成、企業誘致・外資導入の面で光バレー建設を支持する一連の優遇政策を明確にし、「武漢・中国光バレー」を建設する政策的環境をつくり出した。

半導体産業について

半導体チップは「IT産業の基礎」とされるほど、すでに国家安全、経済安全に関わる戦略的な産業と言っても過言ではない。国際通貨基金(IMF)の統計データによると、1枚のチップに100億円の価値があるとすると、関連IT産業の100億円の生産高は、100億円のGDPをもたらすとされている。2013年、世界の半導体市場の総収入額は3,110億米ドルに達した。しかし、コア技術が不十分であるため、中国の半導体チップ製品の国際市場のシェアは僅か10%であり、国内で使われるチップの90%は輸入品で、年間輸入総額は1,650億米ドルに達し、ガソリンの輸入額よりも高いという。

こうした現状から、中国国内の各都市は、半導体生産基地を相次ぎ建設した。今までは北京と上海が産業発展の先陣に立ってきた。武漢はそれらに次ぐ第三の半導体産業基地になることを目指し、無錫、西安などの都市と競い合っている。武漢は、無錫、西安に比べ、専門人材が多く、独自開発能力を持つなどの優位性がある一方で、半導体製品の生産高はまだ低いという遅れを取る分野もある。

2011年7月には、世界的に有名な半導体企業であるアメリカのシノプシス社が、光バレーに研究開発センターを建設し、武漢新芯半導体会社のプロジェクトに参画する予定である。

40-65ナノメートル級のチップは中国国内ではもっとも先進的なチップである。今回、シノプシス社は武漢新芯半導体会社に65ナノメートルのシステムチップ(SOC)のフルソリューションを提供、また40ナノメートルレベルのシステムチップのソフトウェア開発をする予定である。

また、世界有数の電子系設計ソフトウェア(EDAツール)を開発・販売する企業でもあるシノプシス社は、今後、主に電子設計自動化(EDA)のソフトウェア、集積回路(IC)設計および検証プラットフォームの開発業務を展開する予定である。

武漢市は、シノプシス社のような国際的な大企業との連携により、世界の半導体業界での影響力を高め、シノプシス社と連携関係がある企業をはじめとし、さらに多くの半導体企業が光バレーへ進出することを願っている。